

展示会へのご招待

中部地域 最大規模! 電子部品・材料、製造装置、
パワーデバイスなどの最新技術が620社* 出展

第9回

名古屋 ネプコン ジャパン

エレクトロニクス開発・実装展

2026年 **11月25日[水]** ~ **27日[金]** 10:00~17:00

愛知県国際展示場 (Aichi Sky Expo)

主催:RX Japan合同会社

日本シイエムケイが貴殿をご招待いたします

ブース: **ホールD N10-2**

高信頼性HDI

Variation of PPBU structure

車載向けビルドアップ配線板
実績No.1!

PPBU 1-2-1

PPBU 1-4-1

PPBU 2-4-2

放熱対応

CMK-COMP シリーズ

銅ベース
Cu base

銅コア
Cu core

内層厚銅
Inner circuit thick Cu

銅板にダイレクト放熱
Heat radiation directly
to Cu board.

基板全体に熱拡散
Heat-spread to
whole PWB.

断面積拡大により
大電流を許容
High-current can be
allowed with thick Cu.

ワンストップソリューション

CMKにて基板製造を行い、協力会社にて部品調達、実装/組立まで対応、
最適なソリューションをご提供いたします

基板製造 ▶ 部品調達 ▶ 部品実装 ▶ 組立

CMK 生産工場にて

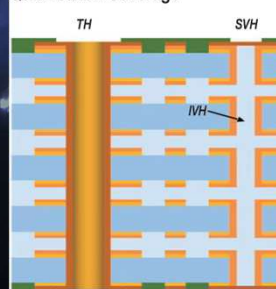
実装協力工場+部品商社にて

共晶半田、医療実績、小ロットなど様々なご要求にお応えできる協力会社様と連携し、
部品実装はもちろん、部品調達・組立も対応いたします

J A X A Qualified Parts

JAXA-QTS-2140B/601

Qualification Coverage



Item		Specification
Dielectric material (Material code)		epoxy (GF) Polyimide (GI)
Processing code		II (Double side) III (Multilayer)
Layer count	TH	Max. 10 layers
	SVH/IVH	2 layer
Board thickness		Max. 1.6mm
Drilled hole	TH	Min. $\phi 0.35\text{mm}$
	Diameter	SVH/IVH Min. $\phi 0.20\text{mm}$
Conductor Width/Space		Min. 0.13mm / 0.18mm
Final surface treatment		Solder coating



こちらをスキャンして
事前登録をお願いいたします

※事前登録制の展示会のため、来場登録をしてからお越しください

<https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1807662065033143-JAY>

貴殿のご来場、心よりお待ちしております!

CMK 日本シイエムケイ株式会社